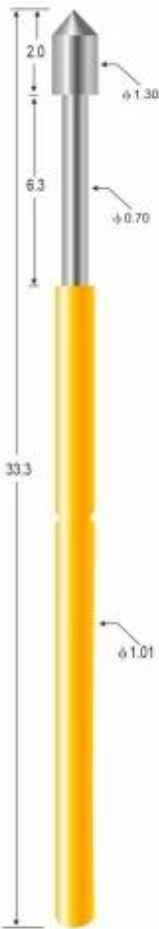
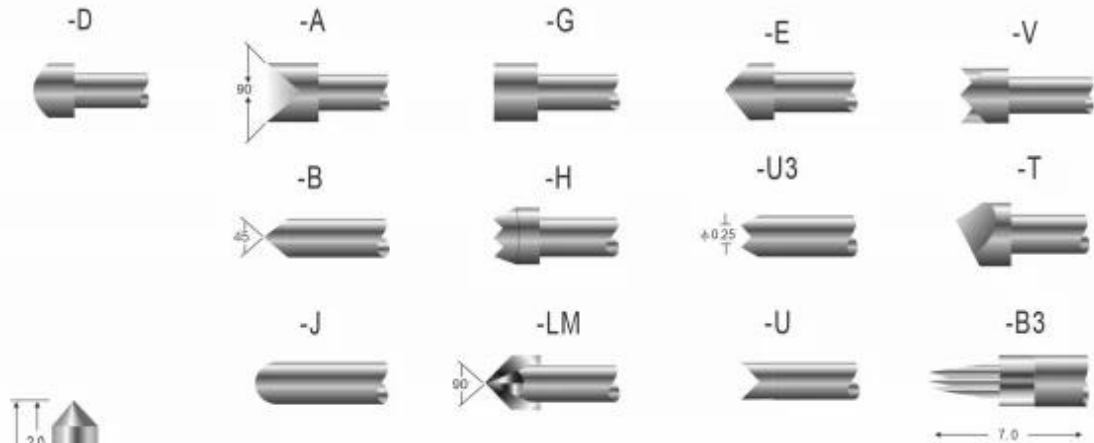


SFENG 1984年 000000 000 000 00 00000. 00, 00, 00, 000 0000 00 000000. (ICT 000 000, ICT 000 000-00) 000 0 00 0 000 0000, 0000 0000 0000, 0000 00 00 0 0 00 000000 000000. 0000 00, 0000, 0000, 00, 00 0 00 00 00 0000 00 000000.



SF-P111-E

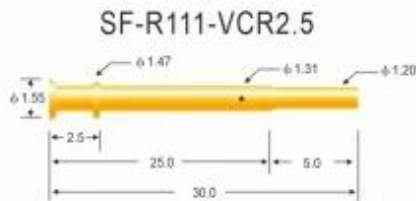
技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Full travel 行程	6.3(.2481 ")
Spring force 弹簧压力	120g(克)
Materials and finishes 材料及涂饰	Plunger:SK4, Ni or Au plated BeCu, Ni or Au plated Phosphor bronze, Ni or Au plated Barrel:Phosphor bronze, Au plated Spring:Stainless steel
Current ration 额定电流	3A(安培)
Contact resistance 接触电阻	50mΩ(毫欧姆)

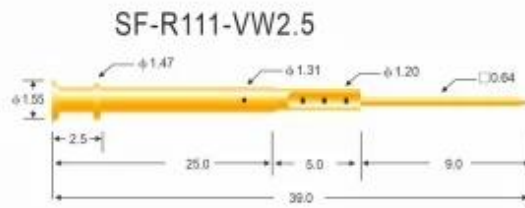
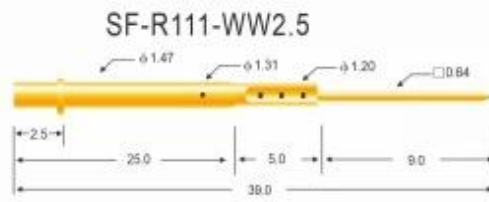
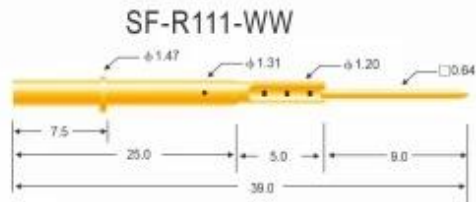
Receptacle specifications
Materials and finishes; Phosphor bronze,Gold plated

技术规格 PROBE SPECIFICATIONS

Recommended minimum center 最小间距	1.90mm(.0748 ")
Mounting hole size 钻孔尺寸	压克力: 1.35mm(.0532 ") 电木板、玻璃纤维板: 1.40mm(.0551 ")
Materials and finishes 材料及涂饰	Barrel: Brass, Au plated
Connections 接线形式	Crimp: R111-VCR2.5, R111-CR Solder cup: R111-VSC2.5, R111-SC Wire wrap: R111-VW2.5, R111-WW2.5, R111-WW Terminal:



Receptacle specifications
Materials and finishes: Phosphor bronze, Gold plated



□□ □□□:

□□ □□	SF-□111
□□ □□ □□	1.90mm(.0748")
□□ □□ □□	□□□: 1.35mm(.0532") □□□□□□, □□ □□ □□: 1.40mm(.0551")
□□ □□	6.30(.2481")
□□□□	120g
□□ □ □□□	□□□: Be Cu, Rh □□ □□ : □□, □□□ □□□ : □□□□□ □□

□□ □□□	3A
□□ □□	50mΩ
MOQ	100□
□□□□	□□□□ □□ □ □□□ □□ 7□

□□□ □□□

1. □□□ 24 □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ OEM□ □□□□□□.
3. □□□ □□□ □□□□ □ □□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□.
4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.

□□ □□

1. PCB, ICT, FCT □□□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□);
2. □□, □□ □□, □□□□, □□□ □ □□□□□ □□□□□□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□ □□ □(□□□□)
3. BGA □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □□□;
4. □□□ □□ □□ □, □□ □, QZ □ VZ □□□□ LM □;
5. □□□ □□□, □□□ □□□, □□□□□ □□;
6. □□□ □ □□□ / □□;
7. □□ □□ □□ □□, 30# OK □□□□, □□ □□ □□, POM, □ □□ □

□□□ □□□ □□□ □□ □ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□!

□□□:





1. Raw material warehouse



2. Lathe workshop



3. Assemble workshop



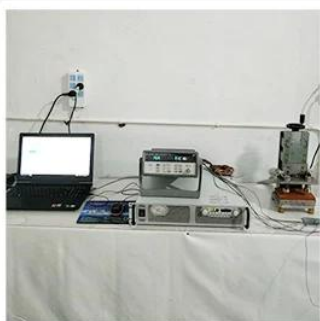
4. Quality inspection



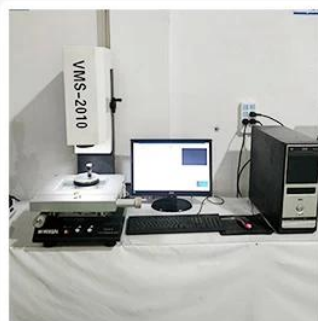
5. Finished products



6. Packing



1. Agilent current testing



2. Quadratic element



3. Load Curve Meter



4. Bond Test



5. Life Fatigue Test



6. Microscope



Q1. 如何選擇供應商?

A1: 選擇供應商, 應考慮其信譽、實力、服務、價格、交貨時間等因素。

Q2. 如何進行品質管理?

A2: 品質管理 QC 應包括來料檢驗、過程檢驗、成品檢驗, 並建立完善的品質管理體系。

Q3. 如何進行庫存管理?

A3: 庫存管理應包括庫存控制、庫存盤點、庫存優化等。

Q4. 如何進行客戶管理?

A4: 客戶管理應包括客戶開發、客戶維護、客戶服務等。

Q5. 如何進行市場推廣?

A5: 市場推廣應包括線上推廣、線下推廣、品牌推廣等。

Q6. 如何進行人力資源管理?

A6: 人力資源管理應包括招聘、培訓、考核、薪酬等。

Q7. OEM與ODM 有何區別?

A7: OEM 是指客戶提供設計圖紙, 廠商負責生產; ODM 是指廠商提供設計圖紙, 客戶負責生產。

Q8. 如何進行物流管理?

A8: 物流管理應包括運輸、倉儲、配送等, 並選擇合適的物流方式。

如何選擇:

DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS 等快遞公司

運費、保險費、關稅等費用, 並選擇合適的貿易術語 Exwork, FOB, CNF, CIF 等。



2023 ISO Certificate



Patent for Coaxial Structure



Patent for Honeycomb current probe











CIBF2021

苏州胜亿福睿电子科技有限公司
Suzhou Shengyifurui Electronic Technology Co., Ltd

No.3B013

